

## GaNeX –circuit PA

REFERENCES				
<b>COMTEAM</b>	Indiquer la référence Comteam (ex : TEAM-01-10) Si c'est un nouveau projet laisser le champ vierge.			
<b>RENATECH</b>	Indiquer la référence du projet dans l'application en ligne Renatech (ex : P-13-00125)		<b>P-</b>	
<b>Objectif du projet</b>	Masquage d'un circuit hybride et assemblage (report) de la puce pour réaliser la fonction amplificateur de puissance			
<b>Année de début</b>	2016		<b>Année de fin prévisible</b>	2016 ou début 2017

### RESSOURCES HUMAINES (Noms, prénoms, statut)

A l'exception des membres de TEAM qui sont déclarés par défaut il est essentiel d'indiquer **toutes les personnes** qui vont être impliquées en salle blanche dans l'année 2016 pour permettre de leur donner les droits adaptés sur l'application de réservation des équipements (<http://lims.laas.fr/default.aspx>) et sur la future application de suivi des procédés.

Porteur			Coordinateur technique		
JG TARTARIN	Pr	Damien SAUGNON	Doc		

### SUPPORT(S) FINANCIER

Renseigner ce paragraphe au mieux permettra une facturation la plus fluide possible et évitera de devoir vous relancer à chaque facturation

Organisme (ANR, Europe, Carnot, ressources propres, etc.)	Nom de l'appel (Pnano, H2020, blanc, etc.)	Acronyme support tel que connu du financeur	N° OTP à la mise en place des crédits (si pas connue info disponible au service gestion)
GANEX	GaNeX	GaNeX fiabilité	Lot fiabilité

### BILAN (cocher la bonne case)

Nouveau projet	Ancien projet non démarré	A jour	En retard	Terminé
X				

En quelques lignes commentaires éventuels sur ce bilan (problèmes rencontrés, résultats probants obtenus, etc...)

En quelques lignes nature des procédés à réaliser

## RESSOURCES TECHNOLOGIQUES QUI SERONT SOLLICITEES

Procédés	Etablis (cocher)	A développer (cocher)	Nb de personnes à former	Précisions si procédés à développer
LITHOGRAPHIE LASER	X		0	
PHOTOLITHOGRAPHIE				
LITHOGRAPHIE ELECTRONIQUE				
NANOREPLICATION				
FOURS	X		0	
IMPLANTATION IONIQUE				
PVD				
ELECTROCHIMIE				
GRAVURE PLASMA				
CHIMIE	X		0	(Gravure chimique de retrait des métalisations Cu (hors pistes))
JET D'ENCRE				
TRAITEMENT DE SURFACE				
EJM				
ASSEMBLAGE	X		0	(Bonding post réalisation de carte)
CARACTERISATION				